

证券代码：301200

证券简称：大族数控

深圳市大族数控科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-001

投资者关系活动类别	<input type="checkbox"/> 特定对象调研 <input type="checkbox"/> 分析师会议 <input type="checkbox"/> 媒体采访 <input checked="" type="checkbox"/> 业绩说明会 <input type="checkbox"/> 新闻发布会 <input type="checkbox"/> 路演活动 <input type="checkbox"/> 现场参观 <input type="checkbox"/> 其他（请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	线上参与公司2025年度网上业绩说明会的投资者
时间	2026年04月10日 15:00-17:00
地点	价值在线（ https://www.ir-online.cn/ ）网络互动
上市公司接待人员姓名	董事长兼总经理 杨朝辉先生 副总经理、财务总监兼董事会秘书 周小东先生 副总经理 宋江涛先生 独立董事 辛国胜先生 保荐代表人 吴斌先生
投资者关系活动主要内容介绍	<p>1.在PCB行业正在扩产时，大族数控怎样抓住市场机会。这次看沪电股份胜宏深南都在扩大产能，对这些龙头企业的扩产，公司有那些应对。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司聚焦并深耕AI算力产业链，与国内外多家龙头PCB企业达成战略合作伙伴关系，并不断与终端客户开展深度交流，在PCB新产品研发设计、工艺革新、技术升级等方面全方位合作，共同研</p>

发具有行业开拓性的产品；同时，针对下游客户积极扩产的规划，公司在提升产品技术能力的基础上加大产能的扩充，助力下游客户快速导入量产。谢谢！

2.25年业绩及26年一季报业绩上升还是下降？公司发展规划。

答：尊敬的投资者，您好！受益于AI算力产业链对PCB产业量价齐升的推动，2025年度公司营业收入577,293.55万元，较上年大幅增长72.68%，归属上市公司股东的净利润82,426.79万元，较上年增长173.68%。根据行业权威机构Prismark的预测，全球电子产业持续在AI算力产业推动下高水平成长，公司将持续围绕“成为世界范围内最受尊敬和信赖的PCB装备服务商”的战略愿景，全面聚焦AI算力场景产业链，持续为下游客户提供技术创新的PCB制造工艺解决方案。公司2026年一季度经营情况请关注公司定期报告。谢谢！

3.1、请问贵司的超快激光钻孔设备目前是否已经在M8材料的PCB板钻孔上规模商用了？大族数控超快激光钻孔设备在业界的总体竞争力如何？对于M9材料的PCB板钻孔验证测试是否已经通过？预计什么时候可以规模商用？ 2、在年报中提到的新型钻孔设备主要是指什么类型的设备？ 3、公司是否有向PCB电镀设备或半导体设备及其它领域横向拓展的计划？ 谢谢！

答：尊敬的投资者，您好！公司新型激光钻孔设备以创新的冷激光工艺，在行业内率先实现了多规格新一代高频高速CCL材料的量产加工，主要功能为盲孔钻孔；同时公司将持续推进新型激光等创新工艺整体解决方案的研发与应用，着力突破传统技术瓶颈，进一步提升在包含先进封装的全球高端PCB制造领域的技术影响力与大族数控品牌信赖度。谢谢！

4.请问贵司截止2025年12月31日公司在手订单规模？公司的生产经营数据信息披露能否保持一致性？

答：尊敬的投资者，您好！公司各项业务发展态势良好，在手订单充足，正有序进行生产和交付。具体经营数据请以公司定期报告披露的信息为准。公司始终严格遵守信息披露规则，确保生产经营数据披露的及时性、准确性和一致性。感谢您对公司的关注。

5.请问贵司的m9级PCB设备是否已量产？

答：尊敬的投资者，您好！针对AI算力PCB材料持续升级的趋势，公司持续推进新型激光、高精度机械加工等技术提升新型材料的加工能力，赋能下游客户生产加工工艺的技术升级。感谢您对公司的关注。

6.请问贵司25年业绩爆发的主要驱动因素是？

答：尊敬的投资者，您好！公司2025年业绩大幅增长主要得益于AI算力产业链基础设施服务器、高速交换机等基础设施需求持续强劲，加上消费电子、汽车电子、工业控制等终端市场技术升级，高价值高多层板、高多层HDI板增长快速，PCB专用加工设备市场需求进一步放大，公司在AI算力PCB专用设备市场快速崛起，主要产品市场占有率及客户认可度持续攀升。谢谢！

7.今年各大pcb厂家扩产对贵公司的影响？

答：尊敬的投资者，您好！下游客户的扩产将较大程度地提升专用加工设备的市场空间，针对下游客户积极扩产的规划，公司在提升产品技术能力的基础上加大产能的扩充，助力下游客户快速导入量产，同时也有助于公司营收的稳健成长。谢谢！

8.公司有规划光模块/cpo相关设备吗？公司在玻璃基板/tgv相关技术的研发进度怎么样？未来如果使用fopl/copos技术，公司会有相应的解决方案吗，如果有

的话公司大概会在什么时候推出相关产品？

答：尊敬的投资者，您好！公司专注于PCB及先进封装领域的专用加工设备的研发制造，下游终端客户的产品有涉及到光模块等产品及FOPLP等先进封装。公司推出的新型激光加工方案、高精度成型方案、高精度检测方案等可用于光模块类载板、玻璃基TGV及先进封装等领域的加工。谢谢！

9.公司既已选择赴港上市，就应当面向全球投资者，对全球投资者负责，后续有关自愿性披露内容能否做到应披尽披？能否学习国际主流的投资者交流方式通过线上直播的形式开展业绩说明会而非文字交流？

答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视信息披露工作，严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》的规定，认真履行信息披露义务，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息。公司已建立多元化的投资者沟通渠道，包括股东会、投资者热线、互动易平台及业绩说明会等。未来公司将结合国际惯例与投资者需求，持续优化信息披露及交流形式。感谢您对公司的关注与建议。

10.您好！为了提高投资者信心，目前很多公司都发布了一季报业绩预告，请问贵司 4月15号之前会发今年的一季报业绩预告吗？

答：尊敬的投资者，您好！根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定，一季度业绩预告不属于强制信息披露事项。具体业绩情况请关注公司后续定期报告。感谢您对公司的关注！

11.我想请教下之前的交流领导有提到说超快激光钻好像有最大的层数限制，那对于超高多层例如正交背板的70层以上pcb的加工，是需要超快激光和CO2激光配合

	<p>使用吗还是用CO2/超快的单一种类设备也可以做？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司新型激光钻孔产品主要用于HDI的增层盲孔，当前行业中超高多层板也有部分产品采用HDI结构，公司将针对不同技术需求提供综合解决方案，包含新型激光钻孔机、CO2激光钻孔机等产品。谢谢！</p> <p>12.请问贵司的超快激光钻孔设备目前在1.6T光模块领域已经开始规模商用了吗？</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！随着AI算力中心传输速率的进一步提升，高速光模块的需求快速增加，提升对高阶任意层类载板需求，公司针对该类产品微小盲孔、超高外形精度等技术要求，提供新型激光加工方案、CCD机械成型机等系列产品并获得下游客户青睐。谢谢！</p> <p>13.公司当前的a股与h股价差较大，h股的价格几乎是a股一半，作为一家成熟企业是否应当对可披露的信息尽可能的披露？以维护价格稳定、促进充分定价和保障不同类别投资者的合法权益。</p> <p>答：尊敬的投资者，您好！公司高度重视信息披露的公平性与透明度，严格按照有关法律法规及《信息披露管理办法》的规定履行披露义务，确保所有投资者平等获取信息。当前价差主要受市场流动性、汇率波动及投资主体差异等综合因素影响，建议投资者理性看待。谢谢！</p>
<p>关于本次活动是否涉及应披露重大信息的说明</p>	<p>本次活动不涉及未公开披露的重大信息。</p>
<p>附件清单（如有）</p>	
<p>日期</p>	<p>2026年04月10日</p>